財團法人工業技術研究院　函

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號
承辦人：賴惠秋
電話：03-5914966
傳真：03-5820466
E-mail：stellalhc@itri.org.tw

108000055914

241 新北市三重區重新路 5 段 609 巷 6 號 3 樓之 3

台灣醫療暨生技器材工業同業公會
收 108. 01. 15 文
檔號: 108030

受文者：臺灣醫療暨生技器材工業同業公會
發文日期：中華民國 108 年 01 月 14 日
發文字號：工研轉字第 1080000559 號
速別：普通件
密等：無
附件：如文

主旨：為本院「生物晶片領域專利讓與案」公開招標活動，敬請轉知 貴會會員等相關廠商重要資訊，把握機會參與本活動，請 查照。

說明：

一、為提昇國內廠商智財防護能力，本院將辦理生物晶片領域相關專利 12 案 15 件之讓與公開招標活動(詳如附件)。

二、有關本活動詳細資訊，請參考下列網站公告：

（一）工研院研發成果公告網站 https://www.itri.org.tw/chi/Content/Bulletin/list.aspx?&SiteID=1&MmmID=3000&SY=0&CatID=1

（二）台灣技術交易資訊網 https://www.twtm.com.tw/Web/news/trans.aspx

三、本案截標日為 108 年 2 月 19 日，開標日為 108 年 2 月 20 日。

四、公開說明會：

（一）舉辦時間：民國（下同）108 年 1 月 30 日下午 14 時至 15 時。

（二）舉辦地點：新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110-1 室。

（三）報名須知：採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 108 年 1 月 29 日中午 12 時整（含）前發送電子郵件（主旨上註明「生物晶片領域專利讓與案公開說明會報名」，並於內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。）向本案聯絡人報名。聯絡人將於 108 年 1 月 29 日下午 6 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。

五、本案聯絡人：

工研院技術移轉與法律中心　賴小姐

電話：(03)591-4966

傳真：(03)582-0466

電子信箱：stellalhc@itri.org.tw

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

正本受文者：臺灣醫療暨生技器材工業同業公會

院長 劉文雄

依權責劃分規定授權業務主管決行

工業技術研究院
Industrial Technology
Research Institute

工業技術研究院
生物晶片領域專利讓與案

有鑑於企業在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，掌握優質專利可形成強有力的防護網，並可藉此累積競爭能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼。財團法人工業技術研究院擬將其所擁有之優質專利，以讓與之方式提供國內廠商，以增加廠商國際競爭力，促進整體產業發展及提升研發成果運用效益。

一、主辦單位：財團法人工業技術研究院（以下簡稱「工研院」）

二、投標廠商資格：

國內依中華民國法令組織登記成立且從事研發、設計、製造或銷售之公司法人。

三、讓與標的：

本讓與案包含生物晶片領域專利 12 案 15 件。以下統稱「讓與標的」。「讓與標的」相關資訊詳如附件或請參考台灣技術交易資訊網(https://www.twtm.com.tw/Web/index.aspx)及工研院研發成果公告網站(https://www.itri.org.tw/chi/Content/Bulletin/list.aspx?&SiteID=1&MmmID=3000&SY=0&CatID=1)。

四、公開說明會與領標：

1. 公開說明會將於民國（下同）108 年 1 月 30 日 14 時整於工研院中興院區 51 館 110-1 室舉辦。
2. 公開說明會採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 108 年 1 月 29 日中午 12 時整（含）前發送電子郵件（請於電子郵件主旨上註明「生物晶片領域專利讓與案公開說明會報名」，並請於電子郵件內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。）予工研院技術移轉與法律中心（以下簡稱「技轉法律中心」）聯絡人（請詳十二、聯絡方式）進行報名。工研院「技轉法律中心」聯絡人將於 108 年 1 月 29 日下午 6 時整（含）前發送電子郵件回覆並告知公開說明會會議資訊。
3. 自本標案公告日起至截標日 108 年 2 月 19 日下午 5 時整(含)止，得洽「技轉法律中心」聯絡人領取標單。

五、投標方法：

1. 本標案採通訊或親送方式投標。投標廠商應按投標單內所列各項目填寫清楚，加蓋投標廠商公司章及負責人章，連同押標金、公司設立證明文件（如營利事業登記證、公司設立核准函、公司登記/變更資料或公司設立登記表影本）、廠商基本資料表(以下統稱「投標文件」)，裝入信封密封之，並在信封上註明「生物晶片領域專利讓與案投標」，於截標日 108 年

2月19日下午5時整（含）前（以送達收據為憑）掛號寄達或親送至：
31057新竹縣竹東鎮中興路四段195號51館110室
工研院技轉法律中心 賴小姐 收

2. 本標案採「案」方式投標。「讓與標的」以同一發明為一案。本標案採一案一標，即同一案專利不分開投標/開標。
3. 本標案不得共同投標或重複投標。
4. 投標後除工研院要求或同意外，投標廠商不得以任何理由撤回或修改其投標單。
5. 投標廠商於投標時，不得附加任何條件。

六、押標金：

1. 押標金為總投標金額之10%，以仟元為最小單位，以下四捨五入。
2. 押標金應以現金匯款、銀行本票或即期支票支付。若以銀行本票或即期支票支付時，請註明受款人為「財團法人工業技術研究院」，並載明禁止背書轉讓。
3. 得標廠商之押標金移充簽約保證金；未得標廠商之押標金，於開標後掛號無息寄回投標廠商。

七、有下列情形之一者，應認為無效投標，無效之投標不進入決標程序：

1. 投標時間截止後之投標。
2. 開標前業已公告停止本標案交易程序。
3. 投標廠商共同投標或重複投標，全部投標均為無效。
4. 投標單附加任何成交條件者。
5. 投標文件之記載不符所定程式或其記載之字跡潦草、模糊，致無法辨識者。
6. 投標文件有所缺漏者。但押標金不足者，工研院得要求投標廠商補足，若於決標前未能補足者，其投標為無效。

八、決標方法：

1. 開標日為108年2月20日(開標時間及地點另行通知投標廠商)。
2. 開標時，先就投標資格、投標單、押標金、公司設立證明文件、廠商基本資料表進行審查及確認。
3. 同一案以投標廠商出價金額最高且高於底價者得標。同一案有二家(含)以上投標金額相同時，由工研院現場抽籤決之。
4. 開標時將請律師到場監標。
5. 開標後將個別通知投標廠商開標結果（不公告得標廠商）。
6. 對於流標、廢標或無效投標之「讓與標的」，工研院得逕洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格。

九、契約事項：

1. 得標廠商應於接獲得標通知起30個工作天內，與工研院簽訂「讓與契約書」。各項契約條件應以工研院與得標廠商正式簽訂之「讓與契約書」為準。工研院保留與得標廠商簽訂「讓與契約書」之權利。
2. 得標廠商如屆期未與工研院簽訂「讓與契約書」時，工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格（但經工研院同意者，不在此限）；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格。
3. 得標廠商與簽訂「讓與契約書」者，須為同一人，否則工研院得沒收簽約保證金並取消得標資格；此外，工研院得另洽第三人為授權或讓與等交易行為，第三人不限於本公告之投標廠商資格。
4. 得標廠商就「讓與標的」同意遵守中華民國相關法令之規定（包括但不限於介入權、境外實施等規定）。前述法令變動時，亦同。
5. 得標廠商取得「讓與標的」應支付工研院讓與費用，讓與費用應以現金支付，但經工研院事前書面同意，得標廠商得以其股票支付，惟其支付方式、內容及相關細節等均應符合工研院之要求。
6. 得標廠商簽署「讓與契約書」且生效時，本標案簽約保證金移充為「讓與契約書」之讓與費用。
7. 「讓與契約書」經雙方依法簽章，及（或）報經濟部同意後生效。得標廠商充分了解「讓與標的」之讓與依規定須送相關主管機關核准，且工研院對於經濟部之意見並無影響能力。
8. 得標廠商同意經濟部及工研院就「讓與標的」，享有永久、無償、全球、非專屬及不可轉讓之使用、實施其全部或部份之權利。得標廠商嗣後若將「讓與標的」專屬授權或讓與第三人時，並應使該第三人同意本條約定。再為專屬授權或讓與時亦同。
9. 得標廠商應就「讓與標的」之一部或全部，承受於「讓與契約書」生效前：1.專利權人已與第三人簽訂之授權契約；2.專利權人已承諾第三人未來得取得非專屬授權之權利；及 3.專利權人已承諾不會對特定之人行使專利權。得標廠商嗣後若將「讓與標的」專屬授權或讓與他人時，並應使該專屬被授權人或受讓人同意本條約定。前述受讓人再為專屬授權或讓與時亦同。
10. 得標廠商同意並承認，「讓與契約書」僅為工研院同意讓與「讓與標的」予得標廠商。工研院亦僅依本標案公告日之「讓與標的」現狀辦理本標案並交付得標廠商，工研院不擔保「讓與標的」之尚在申請中之專利可獲證，或可依原始申請範圍獲證，或已獲證專利不會被撤銷、消滅或其範圍不會變更。工研院亦不擔保「讓與標的」有效性、合用性、商品化、無瑕疵、得向第三人主張權利、不侵害第三人之智慧財產權及可達其他特定目的

之可能性，且不擔保得標廠商利用「讓與標的」所製造產品之產品責任。「讓與標的」之未獲證或被撤銷，工研院毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。得標廠商或第三人因「讓與標的」發生任何損害時，工研院無須負擔任何責任，包括無須負擔相關侵權與瑕疵擔保責任。「讓與契約書」生效後，「讓與標的」之任何舉發、被撤銷或其他糾紛，得標廠商同意自行負責，概與工研院無涉；工研院亦毋須返還或賠償任何款項予得標廠商。此外，工研院並無提供任何有關「讓與標的」之資料文件予得標廠商，或是對得標廠商提供有關「讓與標的」之諮詢講解或訓練之義務。

11. 「讓與標的」之讓與登記手續由得標廠商負責辦理，並由得標廠商負擔讓與手續所需之一切費用。雙方將互相配合以辦理讓與登記所需之手續。得標廠商應自「讓與契約書」生效之日起負擔「讓與標的」之申請維護等相關費用；得標廠商未依規定自行繳費，因而致「讓與標的」發生失效或其他不利益之效果者，概由得標廠商自負其責，工研院毋須為得標廠商之利益繳交專利相關費用或行使任何專利法所規定之權利義務。

12. 「讓與標的」非經工研院事前書面同意，得標廠商不得於中華民國管轄區域（係指台、澎、金、馬，下同）外使用、實施、運用或用以製造相關產品。「讓與標的」有以下情事之一者，得標廠商同意遵守相關之法令規定，配合工研院為一切必要之申請，並應將其檢視該專利運用行為是否可能導致我國核心競爭力之削弱或影響國內研發創新佈局之報告，事前提供工研院。得標廠商且應配合工研院向主管機關(包含但不限經濟部技術處，以下同)及立法院經濟委員會為境外實施等一切必要之申請（包括但不限於境外實施之申請等），並應提供一切相關之文件。得標廠商應於取得工研院、主管機關及立法院經濟委員會核准及同意後始得為之：

(1) 得標廠商在我國管轄區域（係指台、澎、金、馬，下同）外自行使用、實施者；

(2) 得標廠商非專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用者；

(3) 得標廠商專屬授權供非我國研究機構或企業，或在我國管轄區域外製造或使用者；

(4) 得標廠商讓與「讓與標的」之對象非我國研究機構或企業者。

13. 「讓與標的」之得標廠商如有下列各款情事之一時，經濟部或工研院得終止「讓與契約書」，並得將「讓與標的」非專屬授權他人實施，或於必要時將「讓與標的」收歸國有：

(1) 得標廠商於合理時間內無正當理由未有效運用「讓與標的」，且他人曾於該期間內以合理之商業條件，請求授權仍不能達成協議者。

(2) 得標廠商以妨礙環境保護、公共安全或公共衛生之方式實施「讓與標的」者。

(3) 為增進國家重大利益者。

有前項情形時，工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，亦無須負擔損害賠償責任。

14. 得標廠商如將「讓與標的」之全部或一部授權或讓與第三人(以下稱「後手」)時，應將相關授權或讓與對象事前通知工研院，以便工研院向主管機關陳報運用所生之產業效益。

15. 得標廠商應使所有「後手」遵守本條第 8 項至第 10 項、第 12 項至第 14 項、及第 16 項之約定。如「後手」違反前述約定者，視為得標廠商違反前述約定。「後手」再為授權或讓與時，亦同。

16. 基於尊重智慧財產並維護合法授權者之權利，得標廠商欲對依中華民國法律設立之法人或中華民國國民就「讓與標的」主張其權利時，應先定合理期間且以合理之商業條件通知該對象請求協商授權事宜。如經前述協商程序仍不能達成協議，而有必要採取法律行動時，應通知工研院。得標廠商於「讓與契約書」生效後對第三人就「讓與標的」以任何方式主張權利時，得標廠商應自行為該行為、進行該程序或訴訟，工研院無參與得標廠商進行該行為、程序或訴訟之義務。

17. 得標廠商應盡力進行產品開發工作，得標廠商未於合理期間內運用「讓與標的」，工研院得以書面終止「讓與契約書」或將「讓與標的」非專屬授權他人實施，且工研院已收取得標廠商之各項費用或金額無須返還，亦無須負擔損害賠償責任。

十、領標方式：

有意投標者，請與工研院「技轉法律中心」聯絡人(請詳十二、聯絡方式)聯絡，取得投標單。

十一、 注意事項：

本標案公告為「讓與契約書」之一部分。投標廠商之投標行為，視為已充分閱讀、了解並同意本公告、「讓與標的」、投標單及相關資訊之內容。各該內容如有不清楚或牴觸者，工研院保留最終之解釋與決定權利。

十二、 聯絡方式：

本公告相關問題請洽詢：

工研院「技轉法律中心」 賴小姐

電話：(03) 591-4966，傳真：(03) 582-0466

電子信箱：stellalhc@itri.org.tw

地址：31057 新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 51 館 110 室

附件：

專利清單

應用領域	案次	件編號	狀態	專利證號	申請國家	專利中文名稱	專利起期	專利迄期	專利權人	權利屬性
生物晶片	1	134890003TW	獲證	I223069	TW	高活化載片及其製備方法	20041101	20200511	工研院	科專成果；授權中至 2024 年 8 月
生物晶片	2	134890008TW	獲證	176047	TW	高密度官能化載片及其製備方法	20030311	20200903	工研院	科專成果；授權中至 2024 年 8 月
生物晶片	3	134890018TW	獲證	I220676	TW	兩種新基因型態的 ESBLs 之 TEM	20040901	20200917	工研院	科專成果；授權中至 2024 年 8 月
生物晶片	4	134890019TW	獲證	I245771	TW	微區域選擇性活化之疏水性晶片及其製備方法	20051221	20220926	工研院	科專成果；授權中至 2024 年 8 月
生物晶片	5	134900009CN	獲證	ZL02100952.X	CN	微噴液頭以及利用此微噴液頭之噴灑裝置	20051102	20220107	工研院	科專成果；授權中至 2024 年 8 月
		134900009JP	獲證	3634796	JP	微噴液頭以及利用此微噴液頭之噴灑裝置	20050107	20211129	工研院	科專成果；授權中至 2024 年 8 月
		134900009TW	獲證	179615	TW	微噴液頭以及利用此微噴液頭之噴灑裝置	20030511	20211224	工研院	科專成果；授權中至 2024 年 8 月
生物晶片	6	134910001CN	獲證	ZL02118731.2	CN	手持式電泳檢測裝置以及利用此裝置的電泳分离分析系統	20050608	20220429	工研院	科專成果；授權中至 2024 年 8 月
		134910001TW	獲證	175064	TW	手持式電泳檢測裝置以及利用此裝置之電泳分離分析系統	20030301	20220403	工研院	科專成果；授權中至 2024 年 8 月
生物晶片	7	134910005CN	獲證	ZL02126362.0	CN	電泳分離分析系統	20051228	20220718	工研院	科專成果；授權中至 2024 年 8 月
生物晶片	8	134910006CN	獲證	ZL02142083.1	CN	便攜式電泳檢測裝置及其底座	20050615	20220825	工研院	科專成果；授權中至 2024 年 8 月
生物晶片	9	134910012TW	獲證	I247109	TW	電泳檢測裝置用卡匣及其製造方法	20060111	20220909	工研院	科專成果；授權中至 2024 年 8 月
生物晶片	10	P13910028TW	獲證	203440	TW	可程式光藕合寬頻高壓電源調變器	20040521	20221229	工研院	科專成果；授權中至 2024 年 8 月
生物晶片	11	134900010JPD1	獲證	3950146	JP	生物晶片製造裝置及方法	20070427	20220627	工研院	科專成果；授權中至 2024 年 8 月
生物晶片	12	P08910034JP	獲證	3872781	JP	生物晶片製造治具之影像對位裝置及方法	20061027	20230818	工研院	科專成果；授權中至 2024 年 8 月